公司代码:688300 公司简称:联瑞新材

江苏联瑞新材料股份有限公司

2025 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司可能面临的风险已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”中详细描述,敬请投资者查阅。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2025年度利润分配方案为:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元(含税),拟派发现金红利总额为人民币12,073.46万元(含税),占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的41.26%。公司本年度不送红股、不转增股本。上述2025年度利润分配方案按公司2025年年度报告披露日公司总股本241,469,190股计算。

上述利润分配方案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过,尚需经公司2025年年度股东会审议通过后实施。

8、母公司存在未弥补亏损

□适用 √不适用

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	联瑞新材	688300	不适用

1.2公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	柏林	李欣宏
联系地址	江苏省连云港市海州区新浦经济开发区	江苏省连云港市海州区新浦经济开发区
电话	0518-85703939	0518-85703939
传真	0518-85946111	0518-85946111
电子信箱	novoinfo@novoray.com	novoinfo@novoray.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

公司致力于功能性填料行业产品的研发、制造和销售,开展功能性先进粉体材料的研发和制造技术、超微粒子的分散技术、超微粒子的填充排列技术以及超微粒子的表面处理技术为基础的新材料、新技术、新工艺和新应用的研发。

2、主要产品

公司主要产品为功能性先进粉体材料,涵盖微米级和亚微米级角形粉体、微米级至纳米级球形粉体以及其他超微粒子和液态填料等,具有高纯度、高绝缘、低线性膨胀系数、高导热性、低介电损耗、低放射性等特点。产品广泛应用于芯片封装用环氧塑封材料(EMC)、液态塑封材料(LMC)、颗粒状环氧塑封材料(GMC)、底部填充材料(UF)、电子电路基板(CCL)、积层胶膜(BF)、导热材料、特种胶黏剂、蜂窝陶瓷载体以及特高压电力电子制品、3D 打印材料、齿科材料等新兴业务。

3、服务情况

公司致力于成为全球领先的功能性先进粉体材料及应用方案供应商,在“陪你做填料艺术家”愿景的指引下,紧紧围绕行业发展趋势,战略配合国内外行业领先客户。公司产品销售至行业领先的 EMC、LMC、GMC、UF 等封装材料、电子电路基板、导热材料、胶黏剂、先进绝缘制品、蜂窝陶瓷、3D 打印、齿科材料等领域客户,品牌影响力显著提升。公司不仅在传统产品质量方面赢得国内外领先客户认可,而且微米级和亚微米级球形二氧化硅、低放射性球形二氧化硅、低放射性高纯度球形氧化铝、球形二氧化钛、氮化物等产品销售至行业领先客户。公司产品除了在中国大陆销售以外,还在日本、韩国、欧美、东南亚、中国台湾等国家和地区实现销售,公司和诸多国内外知名企业建立了紧密的合作关系。

2.2主要经营模式

研发模式:公司始终高度重视研发工作,坚持以客户需求为导向开展研发。在公司层面设立技术委员会把握公司产品规划和技术方向。技术中心面向新技术、新材料、新应用;工艺部面向新性能、新工艺、新装备;品质管理部负责及时全方位识别客户需求,为客户提供综合解决方案。重视自主创新和产学研用合作创新相结合。

采购模式:公司通过科学管理制度保障采购目标及效率。制度上以质量管理体系为核心,完善供应商导入与持续改善机制,质量管控前移,与供应商建立价值共创伙伴关系,由供应链部统一管理。采用以销定购模式,按订单采购并储备合理库存。严格审核供应商规模、供应半径、反应时间、质量保证、环境安全及资信,编制合格名录并定期评价建档,价格和数量随市场价格和订单而定。

生产模式:公司围绕“及时提供满足顾客要求的产品和服务并持续改进”的质量方针,坚持使用行业一流的设备制造产品,注重现场管理的持续改善、长抓不懈推动员工素养提升、始终保持质量上的高标准,建设了行业一流的智能化生产线,已通过 ISO9001、ISO14001、IATF16949、ISO45001 认证。采取“以销定产”的生产模式,公司提前对接下游客户的应用需求,根据客户需求规划设计产品,使之适应不同行业甚至不同客户的需求,为客户提供性能优异的产品,以此与客户建立长期稳定的信赖合作关系。

销售模式:公司采用直销为主、代理为辅的销售模式。公司始终坚持以客户需求为导向,快速响应客户需求,持续优化配置资源服务客户,针对不同领域客户的需求,设计、建立专业化的技术服务和营销队伍,让客户第一时间准确了解公司和产品,快速准确识别客户需求并提供定制化产品和整体解决方案。公司已形成专业、规范、有序、完善的营销体系。公司与主要客户建立了长期稳定的合作关系,在日常的生产经营中,下游客户向公司提交订单,经公司确认后按订单的具体要求进行发货销售。

2.3所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

1.1行业的发展阶段

公司产品属于新材料行业。新材料行业是国民经济的战略性、先导性产业,对我国由制造大国向制造强国转变具有重要的战略意义。新材料行业的科技创新是赋能各行业科技创新、转型升级、高质量发展的基础,是培育新质生产力的关键领域。根据工信部,2024 年新材料产业总产值预计突破 8 万亿元,2025 年预计将达到10万亿元。在新旧动能转化、产业结构升级的大背景下,人工智能、高速通信、航空航天、新能源等领域等各应用领域的快速发展为新材料的技术研发和推广应用提供了巨大的推动力,作为新材料的硅基氧化物和铝基氧化物等功能性先进粉体材料得到了越来越多的市场机遇,产业链上下游联系愈发紧密,多学科、多部门合作进一步加强,核心技术不断突破,产品类别不断丰富,未来市场前景广阔。

1.1.1半导体封装材料行业

半导体封装是半导体制造的后道工艺,其核心任务是在晶圆完成前道制程后,将其封装为具备完整功能的独立芯片,封装工艺不仅要实现芯片与外部电路之间的电气连接与机械保护,还需确保芯片在复杂工作环境下的可靠性。以引线键合等为代表的传统封装技术,通过将芯片固定于基板并实现引脚连接,满足了保护、连接等基本应用需求;先进封装通过多芯片集成、高密度互连、异构封装等方式,除满足常规的保护、连接外,还可起到提高互联性能、提升功能密度、实现系统重构等作用,成为突破芯片性能瓶颈的关键技术。封装材料位于半导体封装的上游环节,其使用贯穿于整个封装流程,直接影响芯片的封装质量、性能与可靠性。高性能封装材料属于技术含量高、工艺难度大、知识密集型的,是先进封装持续发展的基础。

近年来,以HPC、AI、高速通信等下游应用的需求为牵引,先进封装技术正进入快速发展阶段。据Yole预测,到2030年全球先进封装市场规模将增长至约800亿美元,2024-2030年复合年增长率达到9.4%。从技术结构来看,先进封装涵盖WLCSP(晶圆级芯片规模封装)、FCCSP(倒装芯片级封装)、FCBGA(倒装芯片球栅阵列封装)、2.5D封装、3D封装以及SiP(系统级封装)等多种形态。其中,FC(倒装)技术仍是当前占比最大的细分领域,市场份额超40%。与此同时,受AI及高端算力芯片需求的强力驱动,2.5D/3D等封装技术的市场份额正快速提升,Yole预计其占比将从2023年的27%上升至2029年的40%,年均复合增速高达18.06%,全球先进封装市场正加速向高集成度与异构集成架构演进。在此背景下,先进封装技术对封装材料体系提出了前所未有的升级需求,进而催生出对功能先进粉体材料在大颗粒精准控制、低放射含量、高导热性等方面的系统性升级需求,这一升级需求的变化,探刻改变了填料在先进封装中的角色定位与市场价值,以球形二氧化硅、球形氧化铝等为代表的功能性无机粉体填料正成为决定集成电路封装产业链价值跃升的关键环节,市场空间广阔。

AI服务器、高速通信设备、消费电子、汽车电子、工业控制、医疗、航空航天等行业的不断发展,带动了EMC、LMC、GMC、Underfill等封装材料领域的市场需求,进而对于具有更低 CUT 点、更加紧密填充、更低的放射性含量、高导热性的球形二氧化硅、球形氧化铝等功能性先进粉体材料的市场需求。公司依靠核心技术生产的功能性先进粉体材料具有行业领先的电性能、低 CUT 点、高填充率、高纯度等优良特性,持续精准满足新一代芯片封装材料的高性能要求。

1.1.2电子电路基板行业

覆铜板(CCL)是用于制作印刷电路板(PCB)的重要基材,在PCB中主要起互连导通、绝缘和支撑的作用,其性能对电路中信号的传输速度、能量损失等具有直接影响。覆铜板种类丰富,按大类分为刚性与挠性,全球市场以刚性覆铜板为主。刚性覆铜板一般分为玻纤布基(常规FR4、无铅无卤 FR-4、高 Tg FR-4)、纸基(FR-1等)、复合基(CEM系列)、特殊材料基(包括高频、高速和封装基板),通过制作成PCB,应用于下游各类电子产品需求领域。从发展趋势来看,覆铜板呈现高速高频化发展趋势。

目前,AI、高速通讯、高性能算力等应用领域的正快速发展,带动了算力板卡、交换机与光模块等领域的同步升级,下游硬件对于通讯频率、传输速度等方面性能要求不断提升,为满足日益增长的AI 算力高速数据传输需求,低介电损耗材料应用已成为下游电子电路基板技术发展重要方向,越来越多的电子电路基板厂商已经使用M4-M6材料发展至使用M7-M8等高速材料,更将向使用 M9、M10及以上等级持续发展,以确保高速数据传输的稳定性和可靠性,高性能覆铜板正加速渗透。根据Goldman Sachs Global Investment Research 预计,HDI&高速高频等高阶覆铜板市场2024-2026年均复合增长率高达26%,高性能覆铜板市场需求保持较高景气度。对于覆铜板上游材料而言,需要选择具有较低 Df的材料以保证在使用过程减少信号传输时的衰减、时延,以提高信号完整性,在功能性填料选择上,对于粘径、介电损耗等性能指标要求更为严格,因此,球形二氧化硅等为代表的高性能填料成为行业主流选择。

公司依托42年功能性先进粉体材料的技术积累,突破了高频、高速、HDI、IC载板等高性能电子电路基板用功能填料的核心技术,产品具有低Cut点、低介电损耗、高导热等优良性能,精准满足了高性能覆铜板客户的需求。2025年销售至高性能覆铜板领域的球形二氧化硅等产品营收占比呈上升趋势。

1.1.3导热材料行业

导热材料是电子元件热管理系统的重要组成部分,通过将电子元件产生的热量迅速、高效地传递至外界,从而提升散热性能,达到降低电子元件工作温度、延长其使用寿命的重要作用。导热材料主要包括导热硅脂、导热凝胶、导热垫片、导热灌封胶、导热相变材料等聚合物基导热材料、金属基导热材料、陶瓷基导热材料、碳基导热材料和其他新型导热材料,下游应用场景主要包括消费电子、通信设备、新能源汽车等领域。

在消费电子领域,由于AI、高速通讯、大功率快充等技术在手机、PC、穿戴设备等终端设备持续渗透,使得终端设备处理器能力及功耗均不断提升,发热量急剧增加,散热问题成为终端设备的重要挑战。根据IDC预计,2024年中国市场AI手机出货量为3700万台,2027年将达到1.5 亿台,2024-2027年CAGR为59.45%。随着相关消费电子终端设备智能化持续提升,导热材料作为终端设备的关键散热方案,市场需求空间有望继续扩大。

在通信设备领域,凭借科技创新、市场空间和政策支持,我国通信设备制造业快速发展,已成为全球领先的产业中心,行业规模持续扩展。根据智研咨询数据,我国通信设备制造业市场规模从2015年的16,867.86亿元增长至2023年的26,347.3亿元,年均复合增长率达5.73%。其中,根据TrendForce数据,2023年全球AI服务器出货量为120.5万台,2026年有望达236.9万台,年均复合增速约25%,由于AI服务器严重依赖高速通信技术来构建集群,实现多台服务器、多个GPU之间的高速数据交换和协同计算,AI 等技术的迅速渗透应用发展将带动高速通信设备市场保持增长,导热材料行业也将因此受益。

在新能源汽车领域,导热材料广泛应用于电控模组、驱动电机、动力电池、电源灌封、ADAS 传感器等,导热材料对于各器件稳定、高效、安全的运行起到了关键性作用。根据中汽协数据显示,2025年我国新能源汽车销量达到1649万辆,同比增长28.2%;同期EVTank 统计数据显示,全球新能源汽车销量攀升至2354.2万辆,同比增幅达29.1%。随着新能源汽车的渗透率增长和智能化程度提高,新能源汽车领域对导热材料的需求量与日俱增,已成为导热材料的重要增长点。

导热材料基材往往采用高分子材料,而高分子材料导热性能有限,所以通常需要添加热传导率较高的球形氧化铝等材料来改善其热传导性。伴随高性能导热材料的需求日益提升,催生作为导热填料的球形氧化铝、氮化物等市场需求的提高,导热填料的市场需求及发展前景日趋明显。

1.1.4新应用领域

随着我国国民经济进入高质量发展新阶段,各类新兴行业对功能性先进粉体材料的需求不断提升。在电力电子领域,特高压、AIDC等行业的快速发展,为电力电子用品提供了新的发展机遇。新一代电力电子制品不仅需要承受高压输电时超高电压的极限考验,还对电力电子制品的耐气候、极端条件下局放标准、稳定性、环保性、耐老化等性能提出了更高要求,除了聚合物要求提升外,功能性填料的作用也愈加明显,经过特殊颗粒设计的填料在解决电力电子制品在更加恶劣的气候环境中强度提升、局放降低等方面效果显著。在3D打印材料、齿科材料等领域,微米级、亚微米级、纳米级球形二氧化硅凭借合理的粒度分布、低比表面积、高流动性、适宜的光学特性等特点,大幅度地提升相关制品的性能,功能性先进粉体材料应用领域进一步拓展。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是功能性先进粉体材料领域的领先企业,依托四十余年持续深耕形成的技术底蕴,突破多项核心关键技术,自主研发并掌握了多品类功能性先进粉体材料的生产能力,是全球少数同时掌握火焰熔融法、高温氧化法和液相制备法生产工艺的企业,形成了以硅基氧化物、铝基氧化物产品为基础,多品类规格齐备的产品布局,在稳定供应能力、产品性能、规模、技术上具有行业领先优势。

公司通过自主创新形成了涵盖原料设计、颗粒设计、复合掺杂、高温球化、颗粒分散、液相制备、燃烧合成、晶相调控、表面修饰等核心技术,实现了向全球高端市场突破的跨越式发展,公司已陆续攻克先进封装、新一代高频高速覆铜板、高导热材料等场景用功能性填料的技术难关,成为高性能处理芯片、高性能服务器、高导热材料等尖端领域关键材料供应商。

公司承担了科技部国家重点研发计划、江苏省战略性新兴产业发展专项;完成多项江苏省科技成果转化项目和国家、省级技术革新项目,多项产品被认定为国家重点新产品和江苏省高新技术产品。公司建成并拥有国家特种超细粉体工程技术研究中心硅微粉产业化基地、国家博士后科研工作站、江苏省石英粉体材料工程技术研究中心、江苏省认定企业技术中心、江苏省博士后创新实践基地、江苏省先进级智能工厂、江苏省无机非金属功能性粉体材料工程研究中心和电子封装用石英粉体材料新兴产业标准化试点等称号。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

报告期内,随着AI大模型、高性能计算及高速通信等终端应用的迅猛发展,功能性先进粉体材料在先进封装、高性能电子电路基板、导热材料等下游领域中的战略地位从传统填料向核心材料转变,价值量正快速提升。公司持续聚焦高端芯片(AI、5G、HPC等)封装 、异构集成先进封装(Chiplet、HBM等)、新一代高频高速覆铜板(M8、M9、M10等)、新能源汽车用高导热材料、先进毫米波雷达等下游应用领域的先进技术,深化纳米级球形二氧化硅、高性能球形二氧化钛等功能性先进粉体材料的研究开发及应用推广,持续推出多种规格、低CUT点、表面修饰、Low α微米/亚微米球形二氧化硅、低钠球形氧化铝粉、Low α球形氧化铝、高频高速覆铜板用低损耗/超低损耗/极低损耗球形二氧化硅, 新能源汽车用高导热微米/亚微米球形氧化铝等产品,持续加强功能性粉体材料的研究开发,技术储备二十余年的液相制备球形二氧化硅也正受益于高性能高速基板的发展机遇,产品认证速度不断加快。随着下游应用领域对高性能材料需求持续提升,公司产品结构有望进一步改善,从而推动经营质量不断提升。

在新产业方面,先进封装产业呈现加速渗透态势,2.5D/3D等封装技术快速发展,推动具有精准大颗粒管控、更低CUT点、更加紧密填充、更低的放射性含量、高导热性的球形二氧化硅、球形氧化铝等功能性先进粉体材料在先进封装、高性能电子电路基板、导热材料等下游领域中的战略地位从传统填料向核心材料转变,价值量正快速提升。公司持续聚焦高端芯片(AI、5G、HPC等)封装 、异构集成先进封装(Chiplet、HBM等)、新一代高频高速覆铜板(M8、M9、M10等)、新能源汽车用高导热材料、先进毫米波雷达等下游应用领域的先进技术,深化纳米级球形二氧化硅、高性能球形二氧化钛等功能性先进粉体材料的研究开发及应用推广,持续推出多种规格、低CUT点、表面修饰、Low α微米/亚微米球形二氧化硅、低钠球形氧化铝粉、Low α球形氧化铝、高频高速覆铜板用低损耗/超低损耗/极低损耗球形二氧化硅, 新能源汽车用高导热微米/亚微米球形氧化铝等产品,持续加强功能性粉体材料的研究开发,技术储备二十余年的液相制备球形二氧化硅也正受益于高性能高速基板的发展机遇,产品认证速度不断加快。随着下游应用领域对高性能材料需求持续提升,公司产品结构有望进一步改善,从而推动经营质量不断提升。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	2,350,404,866.18	1,971,962,660.24	14.63	1,764,701,349.09
归属于上市公司股东的净资产	1,705,562,261.94	1,507,675,837.88	13.13	1,347,439,223.00
营业收入	1,115,503,534.99	960,360,374.03	16.15	711,682,420.08
利润总额	334,233,152.74	286,188,151.77	16.79	197,361,403.62
归属于上市公司股东的净利润	292,644,734.72	251,374,413.14	16.42	173,994,421.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	264,214,795.06	226,912,885.41	16.44	150,270,057.37
经营活动产生的现金流量净额	256,480,449.95	254,708,483.84	0.70	246,948,264.23
加权平均净资产收益率(%)	16.38	17.81	增加0.57个百分点	13.60
基本每股收益(元/股)	1.21	1.04	16.35	0.94
稀释每股收益(元/股)	1.21	1.04	16.35	0.94
研发投入占营业收入的比例(%)	5.75	6.29	减少0.54个百分点	6.66

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	238,689,614.37	280,567,827.96	304,582,947.23	291,663,145.43
归属于上市公司股东的净利润	63,027,699.67	75,608,897.31	81,377,731.20	72,620,406.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	58,612,076.79	68,950,669.58	75,283,256.56	61,368,802.13
经营活动产生的现金流量净额	21,460,569.62	21,394,328.81	89,431,841.01	123,193,700.51

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	11,438
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,381
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
广东生益科技股份有限公司	12,963,000	56,173,000	23.26	0	无		境内非国有法人
李晓冬	11,246,597	48,730,929	20.18	0	无		境内自然人
江苏省东海硅微粉厂	9,722,250	42,129,750	17.45	0	无		其他
国企入寿保险有限责任公司-自有资金	650,410	3,689,194	1.53	0	未知		未知
刘春慧	750,700	3,402,000	1.41	0	未知		境内自然人
阮建军	629,939	2,866,025	1.19	0	无		境内自然人
曹家凯	518,520	2,246,920	0.93	0	无		境内自然人
中国建设银行股份有限公司-国寿安保智慧生活股票型证券投资基金	573,696	1,340,634	0.56	0	未知		未知
王松周	146,000	1,306,000	0.54	0	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	83,846	1,290,194	0.53	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明			截至本公告披露之日,李晓冬持有江苏省东海硅微粉厂100%股份,除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情况				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			不适用				

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

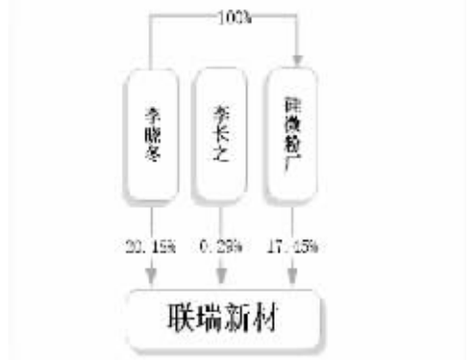
□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入为111,550.35万元,较2024年同期增长16.15%。归属于上市公司股东的净利润29,264.47万元,较2024年同期增长16.42%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688300 证券简称:联瑞新材 公告编号:2026-020

转债代码:118064 转债简称:联瑞转债

江苏联瑞新材料股份有限公司
关于预计2026年度日常性关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东会审议:是

● 日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易属于公司日常性关联交易,是公司正常生产经营业务,主要按照市场价格为定价依据,遵循平等自愿原则,交易风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

江苏联瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月20日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》。本次日常关联交易预计金额合计18,250万元,本次关联交易为向关联人销售商品,向关联人采购原材料和劳务。出席本次会议的董事对各关联方与公司2026年度日常性关联交易的预计情况进行了表决,表决时关联董事回避了表决,非关联董事一致表决通过。

公司董事会审计委员会就该议案形成了书面审核意见:本次日常关联交易符合公开、公平、公正的原则,定价公允;公司与关联方的交易符合公司日常生产经营业务需要,不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益,也不会影响公司的独立性。我们同意本次关联交易事项,并同意将该议案提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。

公司独立董事专门会议对该议案进行审议,全体独立董事一致同意将该议案提交公司第四届董事会第二十一次会议审议,并形成如下意见:公司预计2026年度日常性关联交易是基于正常的生产经营活动而产生的,定价公平、公正、合理,不会对关联人形成依赖。公司与关联方之间发生的关联交易真实、有效,不存在通过关联交易操纵公司利润的情形,亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。我们一致同意公司预计2026年度日常性关联交易事项,并同意将该事项提交公司董事会审议。

本次关联交易事项涉及金额18,250万元,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)等规定,此议案尚需提交公司股东会审议,关联股东将按照规定回避表决。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	2026年度预计金额	占同类业务比例(%)	2026年年初至披露日前上一月末与关联人累计已发生的交易金额	2025年度实际发生金额	占同类业务比例(%)	2026年度预计金额与2025年度实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品	广东生益科技股份有限公司	16,800	15.08%	1,716.65	4,874.74	4.38%	预计需求变化
	常熟生益科技有限公司			872.38	3,183.36	2.86%	
	苏州生益科技有限公司			34.01	217.33	0.20%	
	陕西生益科技有限公司			374.81	1,466.40	1.32%	
	江西生益科技有限公司			405.05	1,356.53	1.22%	
	生益科技(泰国)有限公司			220.26	723.08	0.65%	
	生益电子股份有限公司	200	0.19%	0.00	0.00	0.00%	预计需求变化
	吉安生益电子有限公司			20.94	79.24	0.07%	
	生益电子(泰国)有限公司			5.33	16.05	0.01%	
	小计	17,000	15.27%	3,649.42	11,916.73	10.70%	/
向关联人购买原材料	广东生益科技股份有限公司	1,200	1.84%	206.41	784.34	1.20%	预计需求变化
	小计	1,200	1.84%	206.41	784.34	1.20%	/
接受关联人提供的劳务	广东生益科技股份有限公司	50	23.26%	0.00	99.48	46.29%	/
	小计	50	23.26%	0.00	99.48	46.29%	/
合计		18,250	/	3,855.83	12,800.54	/	/

注:1、占同类业务比例计算公式的分母为公司2025年同类业务实际发生额。

2、上述预计关联交易总额为18,250万元,苏州生益科技有限公司、陕西生益科技有限公司、常熟生益科技有限公司等9家公司均为广东生益科技股份有限公司全资或控股的子公司或孙公司。公司与上述关联方关联交易金额会因其订单之间的分配调整导致相应的金额调整。

3、由于关联交易数据统计存在一定的客观因素,为了保证关联交易数据的准确性,故统计2026年年初至披露日前上一月末与关联人累计已发生的交易金额。

4、与关联人发生的日常关联交易,交易主体是江苏联瑞新材料股份有限公司及其全资子公司联瑞新材(连云港)有限公司。

(三)上一年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额	2025年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品	广东生益科技股份有限公司	7,000	4,874.74	业务量调整
	常熟生益科技有限公司	1,800	3,183.36	业务量调整
	苏州生益科技有限公司	550	217.33	业务量调整
	陕西生益科技有限公司	1,300	1,466.40	/
	江西生益科技有限公司	700	1,356.53	业务量调整
	江苏生益特种材料有限公司	600	723.08	/
	生益电子股份有限公司	80	79.24	/
	吉安生益电子有限公司	30	16.05	/
	小计	12,060	11,916.73	/
向关联人购买原材料	广东生益科技股份有限公司	600	784.34	/
	小计	600	784.34	/
接受关联人提供的劳务	广东生益科技股份有限公司	0	99.48	/
	小计	0	99.48	/
合计		12,660	12,800.54	/

注:2025年度实际发生金额已经审计。

根据《董事会议事规则》,以上超额情况未达到董事会审批权限,基于经营的需要,由公司管理层确定执行,现提请董事会对2025年年度日常关联交易情况进行确认。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)广东生益科技股份有限公司

1、基本情况

企业名称	广东生益科技股份有限公司
公司类型	股份有限公司(港澳台投资、上市)
法定代表人	施仁彦
注册资本	242,911.9230万人民币
成立日期	1985年6月27日
住所	广东省东莞市松山湖园区工业西路5号
主要办公地点	广东省东莞市松山湖园区工业西路5号
经营范围	设计、生产和销售覆铜板和粘结片、印刷线路板、胶膜电子元件、液晶产品、电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔、电子用挠性材料、显示材料、封装材料、绝缘材料的制造与租赁,研究与设计,零售批发,进出口。
财务数据	参见广东生益科技股份有限公司披露的定期报告
主要股东	广东生益科技股份有限公司

2、关联关系

广东生益科技股份有限公司为公司的股东,持有公司23.26%的股份,为公司关联方。

(二)常熟生益科技有限公司

1、基本情况

企业名称	常熟生益科技有限公司
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	焦锋
注册资本	90,000.00万人民币
成立日期	2014年06月24日
住所	常熟高新技术产业开发区香润路99号
主要办公地点	常熟高新技术产业开发区香润路99号
经营范围	研发、生产、销售覆铜板、胶膜、树脂及相关原材料、半固化片、印刷线路板、电子元件、液晶产品、电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔、电子用挠性材料、显示材料、封装材料、绝缘材料的制造与租赁,研究与设计,零售批发,进出口,技术咨询、技术转让及相关服务,道路普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
财务数据	参见广东生益科技股份有限公司披露的定期报告
主要股东	广东生益科技股份有限公司

2、关联关系

常熟生益科技有限公司为苏州生益科技有限公司持股100%的子公司,苏州生益科技有限公司为广东生益科技股份有限公司持股100%的子公司。

(三)苏州生益科技有限公司

1、基本情况

企业名称	苏州生益科技有限公司
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	施仁彦
注册资本	84,187.111579万人民币
成立日期	2002年7月24日
住所	苏州工业园区星龙街288号
主要办公地点	苏州工业园区星龙街288号
经营范围	设计、生产覆铜板和粘结片、印刷线路板、胶膜电子元件、液晶产品、电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔、电子用挠性材料、显示材料、封装材料、绝缘材料的制造与租赁,研究与设计,零售批发,进出口,佣金代理(拍卖除外)及相关业务;提供仓储、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
财务数据	参见广东生益科技股份有限公司披露的定期报告
主要股东	广东生益科技股份有限公司

2、关联关系

苏州生益科技有限公司为广东生益科技股份有限公司持股100%的子公司。

(四)陕西生益科技有限公司

1、基本情况

企业名称	陕西生益科技有限公司
公司类型	有限责任公司(外商投资企业法人独资)
法定代表人	施仁彦
注册资本	135,488.25万人民币
成立日期	2000年12月28日
住所	陕西省咸阳市秦都区永昌路8号
主要办公地点	陕西省咸阳市秦都区永昌路8号
经营范围	覆铜板、绝缘板、粘结片及其衍生工、电子、电工材料、覆铜板专用设备开发、研制、销售、技术咨询及服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
财务数据	参见广东生益科技股份有限公司披露的定期报告
主要股东	广东生益科技股份有限公司

2、关联关系

陕西生益科技有限公司为广东生益科技股份有限公司持股100%的子公司。

(五)江西生益科技有限公司

1、基本情况

企业名称	江西生益科技有限公司
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	施仁彦
注册资本	140,000.00万人民币
成立日期	2017年11月20日
住所	江西省九江市经开区城西港区港兴路6号
主要办公地点	江西省九江市经开区城西港区港兴路6号
经营范围	设计、生产和销售覆铜板和粘结片、印刷线路板、胶膜电子元件、液晶产品、电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔、电子用挠性材料、显示材料、封装材料、绝缘材料的制造与租赁(以上均不含电镀),自有房屋出租,从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务,从事零售及技术的进出口业务;经国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(前述除外)
财务数据	参见广东生益科技股份有限公司披露的定期报告
主要股东	广东生益科技股份有限公司

2、关联关系

江西生益科技有限公司为广东生益科技股份有限公司持股100%的子公司。

(六)